

第86回応用物理学会秋季学術講演会 ランチョンセミナーのご案内

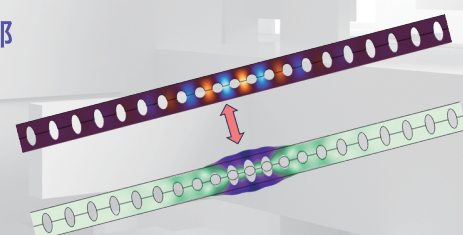
次世代デバイス設計・製造のための マルチフィジックス数値シミュレーション

講師 **福川 真**

計測エンジニアリングシステム株式会社 技術部

日時 **9月7日(日) 12:20～13:00**

会場 **N106** | 定員 **50名**



共振器オプトメカニクスの解析事例

概要

近年、AI 技術や機械学習の急速な進展に伴い、それらを支えるハードウェア基盤として、光学・電子デバイス技術の高度化が世界的に求められています。これらの先端技術を設計・製造するためには、新しい物理的機構を考慮した解析が不可欠です。そのため、多重物理現象を扱え、かつ支配方程式を任意に組み込むことが可能な数値解析ソフト「COMSOL Multiphysics®」が有効なツールとなります。本セミナーでは、COMSOL Multiphysics® を用いた先端デバイス関連の解析事例を紹介しながら、多重物理モデリングおよび方程式の組み込み機能による柔軟なモデリング手法をデモンストレーションします。数値解析による先端デバイス設計を検討されている皆様に向けて、物理メカニズムの可視化から設計への応用まで、最新事例を通じて COMSOL Multiphysics® の有用性をご体感いただきます。

こんな方におすすめ

- ・ 光学デバイス・MEMS デバイス・半導体・半導体デバイスの設計・製造に携わっている方で数値シミュレーションの導入を検討されている方
- ・ マルチフィジックス解析に興味がある方
- ・ シングルフィジックス解析をされていて数値解析の限界を感じておられる方

申込 **学会 WEB サイトにて事前申し込み**

※残席がある場合、当日会場にて参加受付

講演会オフィシャルページ <https://meeting.jsap.or.jp/>



お問い合わせ

COMSOL Multiphysics® 日本総代理店

KESCO KEISOKU ENGINEERING SYSTEM
計測エンジニアリングシステム株式会社

TEL : 03-5282-7040

MAIL : kesco_sales@kesco.co.jp

<https://kesco.co.jp/>

